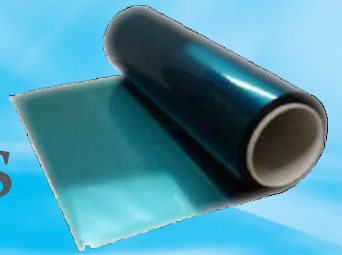


Soluble Dry Film Photoresist

MS 9000 series

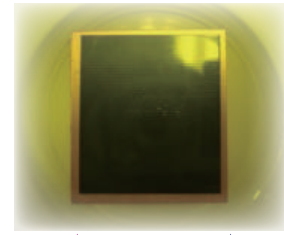


溶解型厚乾膜系列

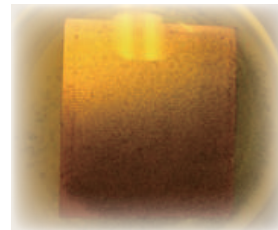
**可溶解於剝膜液！
不需要特別移除！**

Dissolved on Stripping Process!

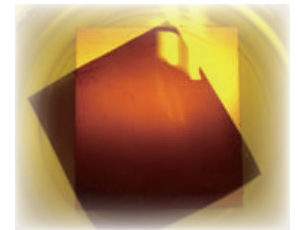
- 剝膜製程中 光阻會裂化成細小碎片 並完成溶解於剝膜液中
- 剝膜製程中能避免勾膜或反沾現象 減少重工及後續製程發生問題的風險。



裂化並於剝膜液中溶解！
Crumbled and Dissolved!



MS9050



一般的DFR
General DFR

極佳附著能力！

Excellent Adhesion!

優異的蝕刻液阻抗能力！

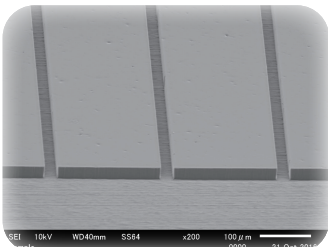
High Durability for Etching Solution!

型號 Type	光阻厚度 Thickness of Resist Layer
MS 9050	50 μm
MS 9025	25 μm

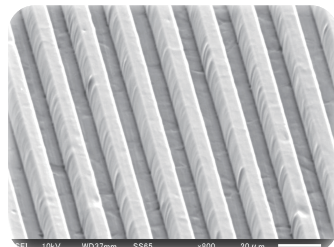
高解析度 MS 9015 LF

高解析能力光阻

光阻顯影圖像 Resist Pattern



Space 20 μm



L/S = 10 μm / 10 μm

型號 Type	光阻厚度 Thickness of Resist Layer
MS 9015 LF	15 μm



**MITSUBISHI
PAPER MILLS
LIMITED** 三菱製紙株式会社
イメージング事業部
電材ビジネスユニット

〒300-4247 茨城県つくば市和台46番地
TEL: 029-864-3530
Email: denzai@mpm.co.jp
URL: <https://www.mpm.co.jp/>